

**Q1：wafer cassette 有哪些材料组成？**

A1：wafer cassette 因其应用的制程不一样，常见的有特氟龙 PFA（perfluoro alkoxy）,PEEK（Polyether ether ketone）,PBT（permanent antistatic PBT alloy）,PP（polypropylene）等等材质。

**Q2：wafer cassette 大概分类？**

A2：因为晶圆尺寸来份，我们 Dainichi 产品有：2 寸，2.5 寸，3 寸，4 寸，5 寸，6 寸，8 寸，12 寸的 wafer cassette；

如按照承载晶圆的片数来分，我们 Dainichi 产品主要有：13 片装的，25 片装的，26 片装，50 片装。

**Q3：大陆半导体厂主要用的灭火系统是哪些？**

A3：半导体厂制程先进，一般采用国外进口灭火系统，大陆新安装的灭火系统一般采用日本的 HATSUTA（初田），二手机台部分自带灭火系统，如美国的 ANSUL，KIDDE。其中初田的产品功能最全面，安全性最高，价格也最高。

**Q4：选择灭火系统有什么建议？经常和灭火系统联系在一起的 FM 认证是什么？**

A4：选择灭火系统时需要考虑：

1. FM 认可（FM Approvals）——进入全球市场的证书 FM 全球公司通过其所属的“FM 认可”（FM Approvals）机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。“FM 认可”证书在全球范围内被普遍承认，一般只有获得 FM 认证的消防产品才能够投保有关的财产险或者火灾险，否则保险公司拒绝保险人投保。

2. 系统稳定性，一方面是各类感应器的灵敏度和稳定性（设计原理和质量），因为市场上有的产品虽然通过 FM 认证但其感应器是一次性的，不仅容易误作动，而且一旦触发，不更换就不能开机使用，后续费用不菲。另一方面是系统智能性，是否拥有自检系统，感应器是否有控制卡，如果各器件出现问题是否可以智能报警而非直接触发 ERC 安全警报。

**Q5: CMP 研磨液(Slurry)的组成是什么？**

A5: CMP 研磨液（Slurry）是由研磨颗粒(Abrasive particles)，以及能对被研磨膜起化学反应的化学溶液组成

**Q6: 目前 CMP 研磨液有哪些分类？**

A6: 根据研磨对象不同主要分为：硅研磨(Poly CMP)、硅氧化物研磨(Oxide CMP)、钨研磨(W CMP)和铜研磨(Cu CMP)；

我司为日本 Fujimi CMP slurry 在中国的代理商，主要产品有 Oxide slurry, Poly slurry 和 Cu slurry.